

製作內容

料號 AGF7168_Burn In MotherBoard_V01 材質 IT-180A

層數 4 成品板厚 1.6mm

成品尺寸

表面處理 化金3u"

防焊印刷 綠

外層銅厚 1.0 oz 內層銅厚 1.0 oz

文字印刷 雙面

文字顏色 白

油墨塞孔 有

電測 有

BGA 無

阻抗控制 無

最小線寬 4 mil

最小線距 4 mil

最小孔徑 7.87 mil

金手指 無

樹塞(VIA)有 (0.3以下)

板邊鍍銅/半圓孔 無

喇叭孔 無 盲撈 無

碳墨印刷 無

備註 1) Stack-up_20260921

製作數量8PCS
加上折邊

YR YourPCB Technology Co., Ltd.												
Stack-up												
Material :			IT-180A			Impedance						
Drill Structure		Layer :		4 Layers		Thickness		Single-ended		Zo	Differential	Zo
Green Solder Mask Ink						0.70	mils	0.018	mm			
		L1		Copper+Plating	1.50	mils	0.038	mm	5.5mil · Gap 10mil · 50Ω±10% · Ref L2			
				Prepreg	3.50	mils	0.089	mm				
		L2		Copper	1.30	mils	0.033	mm				
				Core	48.00	mils	1.219	mm				
		L3		Copper	1.30	mils	0.033	mm				
				Prepreg	3.50	mils	0.089	mm				
		L4		Copper+Plating	1.50	mils	0.038	mm	5.5mil · Gap 10mil · 50Ω±10% · Ref L3			
Green Solder Mask Ink						0.70	mils	0.018	mm			
Total						62.00	mils	1.575	mm			
SPEC						1.6mm ±10%						

製作內容

料號 AGF7168_DaughterBoard_V01 材質 IT-180A
層數 4 成品板厚 1.4mm
成品尺寸
表面處理 化金3u"
防焊印刷 綠
外層銅厚 1.0 oz 內層銅厚 1.0 oz
文字印刷 雙面
文字顏色 白
油墨塞孔 有
電測 有
BGA 無
阻抗控制 有
最小線寬 4 mil
最小線距 4 mil
最小孔徑 7.87 mil
金手指 無
樹塞(VIA)有 (0.3以下)
板邊鍍銅/半圓孔 無
喇叭孔 無 盲撈 無
碳墨印刷 無
備註 1) Stack-up_20260921

製作數量120PCS
需排連片 1PNL = 2A



YourPCB Technology Co., Ltd.

Stack-up

Material :				IT-180A		Impedance			
Drill Structure	Layer :		4 Layers	Thickness		Single-ended	Zo	Differential	Zo
			Green Solder Mask Ink	0.70	0.018				
	L1		Copper+Plating	1.50	0.038	5.5mil · Gap 10mil · 50Ω±10% · Ref L2			
			Prepreg	3.50	0.089				
	L2		Copper	1.30	0.033				
			Core	41.00	1.041				
	L3		Copper	1.30	0.033				
			Prepreg	3.50	0.089				
	L4		Copper+Plating	1.50	0.038	5.5mil · Gap 10mil · 50Ω±10% · Ref L3			
			Green Solder Mask Ink	0.70	0.018				
Total				55.00	1.397				
SPEC				1.4mm ±10%					